

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05152468 A
TITLE: IC SOCKET

TTL:
IC SOCKET

CCXR:
257/686

CCXR:
257/723

FPAR:
PURPOSE: To provide an IC socket usable for hybrid IC PCB mounting.

FPAR:
CONSTITUTION: An IC socket which has contact pins 2 for inserting IC leads is separated into a plurality of blocks 1 each of which has several contact pins
2. Each block separating plane is provided with a protruding part 3 which has dove tail shaped cross-section and a recessed part 4 so as to be fitted each other and the necessary number of the blocks 1 are integrally connected. Thus, the number of contact pins of the IC socket is discretionally set and the substrate mounting efficiency of an hybrid IC is improved.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-152468

(43)公開日 平成5年(1993)6月18日

(51)Int.Cl.⁵

H01L 23/32

識別記号

庁内整理番号

A 7220-4M

FI

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数2(全 3 頁)

(21)出願番号 特願平3-337774

(22)出願日 平成3年(1991)11月26日

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 戸田 くり子

兵庫県川西市久代3丁目13番21号 株式会社ケーデイエール内

(72)発明者 杉本 維平

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所内

(74)代理人 弁理士 村上 博 (外1名)

(54)【発明の名称】 ICソケット

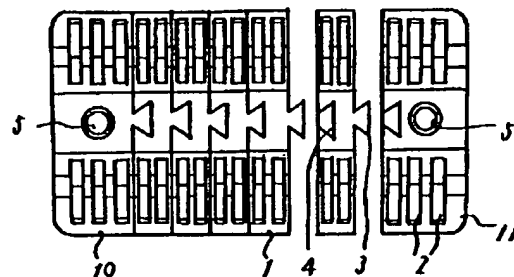
(57)【要約】

【目的】 ハイブリッドICのPCB実装に有効なICソケットを得る。

【構成】 ICリード挿入用のコンタクトピン2を有するICソケットを、1ブロックが数個のコンタクトピン2を有する複数ブロック1に分割し、各ブロック分割面に相互に嵌合可能な断面がダブテール形の凸部3と凹部4を設け、必要個数のブロック1を接続一体とした。

【効果】 ICソケットのコンタクトピン数を任意に設定でき、ハイブリッドICの基板実装効率を高めることができる。

1:ブロックパッケージ 4:凹部
2:コンタクトピン 5:めじ穴
3:凸部 10,11:插ブロックパッケージ



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ICリード挿入用のコンタクトピンを有するICソケットを、1ブロックが数個のコンタクトピンを有する複数ブロックに分割し、各ブロックの分割面に相互に嵌合可能な断面がダブテール形の凸部と凹部を設け、必要個数のブロックを上記凸部、凹部により嵌合して接続一体とすることにより、コンタクトピン数を任意に設定できるようにしたことを特徴とするICソケット。

【請求項2】 分割されたブロックの一つの面にダブテール形の凸部と凹部とを共に備えたことを特徴とする請求項1記載のICソケット。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】この発明は、ICソケットに関するものである。

【0002】

【従来の技術】図5、図6はそれぞれ従来のICソケットを示す平面図で、図において、1はパッケージ部、2はリード挿入コンタクトピン部、3はソケット取付け用フランジ部である。

【0003】次に動作について説明する。パッケージ1はICをプリント基板に実装するためのものであり、振動等の外的要因を吸収しICを保持すると共に、ICの交換を容易にすることが出来、コンタクト部2にICリードフレームを挿入して使用する。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】従来のICソケットは以上のように構成されているので、多品種パッケージのハイブリットICには適当なサイズのソケットを使用する事が極めて困難であるという問題があった。

【0005】この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、ICソケットのピン数を任意に設定できるようにし、多品種のICに使用できるようにしたICソケットを提供するものである。

【0006】

【課題を解決するための手段】この発明に係るICソケットは、ICリードのコンタクトピン数を任意に設定出来るように、ソケットを1ブロックが数個のコンタクトピンを有する数ブロックに分割し、各ブロックの分割面に相互に嵌合可能な断面がダブテール形の凸部と凹部を設け、必要個数のブロックを上記凸部、凹部により嵌合して接続一体としたものである。

【0007】

【作用】この発明におけるICソケットパッケージは、ピン数を任意に設定出来るため、ハイブリットIC等のPCB実装効率を上げることに有効である。

【0008】

【実施例】以下この発明の一実施例を図について説明す

2

はコンタクト、3はブロックパッケージ1のコンタクト2の開口面と直交する面に突出して設けられたダブテール形凸部、4は同じくダブテール形凹部で、凸部3は凹部4に嵌合可能になされている。10はダブテール形凸部3及び固定用のねじ穴5を有する端ブロックパッケージ、11はダブテール形凹部及び固定用のねじ穴5を有する端ブロックパッケージである。なお、各ブロックパッケージは2個のピンを有する単位で分割されているが、場合によっては1個のピン単位でも、3個以上のピン単位でもよい。

【0009】次に作用について説明する。コンタクトピン2の必要設定数に応じて、端ブロックパッケージ10、11の間にブロックパッケージ1を必要個数だけ凸部3と凹部4を嵌合することにより接続一体化する。完成したソケットはねじ穴5によりねじで基板に取付けられる。

【0010】実施例2. 図3、図4はこの発明の他の実施例を示すもので、これはブロックパッケージ1のコンタクト2の開口面と直交する面にそれぞれダブテール形凸部3とダブテール形凹部4とを設けたものであり、勿論、端ブロックパッケージ10、11にも当該面にそれぞれ凸部3と凹部4が設けられている。そして、上記凸部3と凹部4は嵌合可能になされている。

【0011】この実施例のものも、コンタクトピン2の必要設定数に応じて、端ブロックパッケージ10、11の間にブロックパッケージ1を必要個数だけ凸部3と凹部4を嵌合することにより接続一体化するが、接合面に凸部と凹部の両方が設けられているため、接続が強固になる。

【0012】

【発明の効果】以上のようにこの発明によれば、ICソケットのコンタクトピン数を任意に設定できるため、多品種のハイブリットICのPCB実装を効率よくする事が出来、また、ICリードの誤挿入を未然に防ぐ効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例を示す平面図である。

【図2】図1の一部拡大斜視図である。

【図3】この発明の他の実施例を示す平面図である。

【図4】この発明の他の実施例を示す斜視図である。

【図5】従来装置を示す平面図である。

【図6】従来装置を示す平面図である。

【符号の説明】

1 ブロックパッケージ

2 コンタクトピン

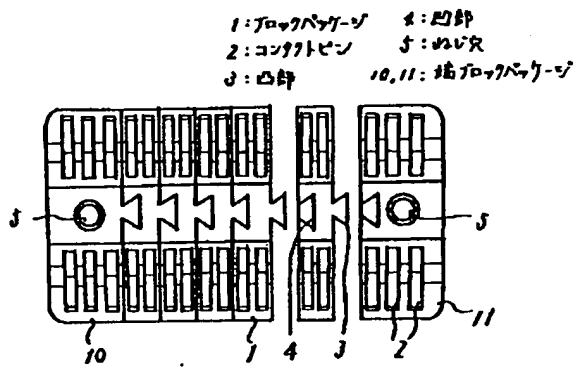
3 凸部

4 凹部

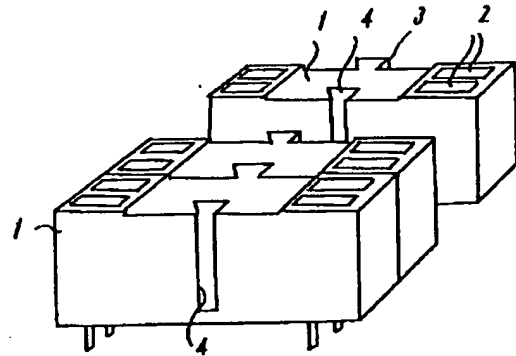
5 ねじ穴

10、11 端ブロックパッケージ

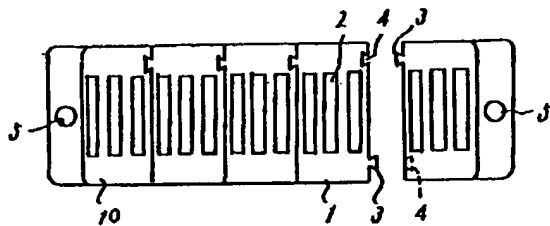
【図1】



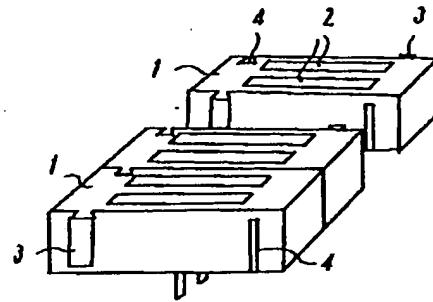
【図2】



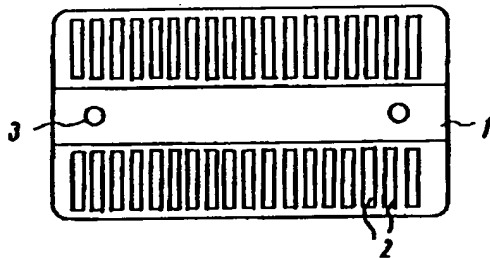
【図3】



【図4】



【図5】



【図6】

